有研半导体硅材料股份公司

2025 年 10 月投资者关系活动记录表

	☑特定对象调研	□分析师会议	
投资者关系活动	□媒体采访	□业绩说明会	
类别	□新闻发布会	□路演活动	
	□现场参观	□其他	
时间	参与单位名称及人员姓名		
2025年10月28日	中邮证券等机构投资者共计约 20 人		
13:30-14:30			
地点		公司会议室	
上市公司接待	董事会	秘书、财务总监 杨波	
人员姓名	ù	E券事务代表 孙媛	
	一、公司基本情况	介绍	
	就公司基本概	况、前三季度经营情况等进行介绍。	
	2025 年前三季	度,公司实现营业收入7.47亿元,	
	同比下降 3.43%, 非	其中主营业务收入实现小幅增长; 利	
	润总额 2.2 亿元,	同比下降 13%,净利润 1.84 亿元,	
	同比下降 17%; 经营	性现金流 2.01 亿元,同比增长 40%。	
	半导体硅片产	品产销量实现双增,产量与销量分别	
投资者关系活动主要	同比增加 15%、5%。	通过持续优化产品结构,同时保持	
内容介绍	高位产销率和稼动	率, 硅片各类产品实现综合毛利率同	
	比增长,保持了硅	片产品的整体盈利水平。	
	刻蚀设备用硅材料及部件前三季度营业收入 2.34		
	亿元,与上年基本技	寺平, 硅部件成品和多晶新产品贡献	
	部分增量收入。		

区熔单晶产销量同比增长,其中8英寸区熔产品贡献了主要增量。在国产替代方面,区熔产品从设备到原材料各环节已全部实现国产化。

二、问答环节主要内容

1、公司在存储领域是否有相关客户?若有,进展如何?

公司在存储领域已形成多维布局。刻蚀设备用零部件产品已进入存储类客户供应链,其中长江存储处于认证阶段;同时公司通过控股股东的子公司向台积电供应零部件产品,从而间接进入存储领域。此外,参股公司山东有研艾斯的12英寸硅片已实现向长江存储供货。

2、公司6英寸、8英寸及12英寸硅片的产能、稼动率如何?

公司德州基地 6 英寸、8 英寸硅片产能合计 550 万 片/年,硅片产品稼动率在 95%以上。

12 英寸硅片目前设计产能为10万片/月,预计2025 年底将提升至15万片/月,因产品目前处于认证阶段, 稼动率有待提升。

3、公司 8 英寸硅片各类产品的占比、毛利率情况如何? 对 2026 年硅片市场增长有何预期?

公司8英寸硅片产品主要分为重掺片、轻掺片及超低阻等特色硅片。其中,重掺占比约60%-70%,轻掺占比约25%,特色产品占比约10%。公司通过技术降本,毛利率较上年有所提升。为满足市场需求,进一步提高公司产品交付率,公司已启动8英寸硅片再扩产项目,计划新增5万片/月产能。

8 英寸硅片市场虽为存量竞争,但公司具备自身的

技术、人才及研发优势。根据 SEMI 统计,2025年二季度,全球8英寸硅片出货量呈现增长态势。虽然消费类市场短期受政策和库存影响,面临一定压力,但长期来看增长动力强劲。此外,功率集成电路的关键技术(BCD)领域市场需求活跃。

4、公司刻蚀设备用硅材料的客户结构如何?多晶硅铸锭产品的主要应用领域有哪些?

公司刻蚀设备用硅材料中材料类产品主要出口至 日本、韩国;部件类产品正在积极开展国内市场推广和 客户验证,部分产品已通过国内龙头设备厂认证。多晶 产品是公司近年研发的新产品,已通过国内外客户的认 证,今年四季度实现批量供货。预计 2026 年将成为新 的利润增长点。

多晶硅铸锭产品主要应用于刻蚀设备的大型结构件和电极部件,为保证刻蚀机内部的纯度和提高刻蚀的精度,用多晶材料替代陶瓷和石英做成部件配套高精度刻蚀机使用。2026年有望实现大幅增长。该产品盈利能力强劲,附加值较大。

5、公司并购情况进展如何?

公司并购日本株式会社 DG Technologies 项目,已取得中国政府的 ODI 审批,目前正在等待日本经产省的审批。

附件清单	
(如有)	

无

日期

2025年10月30日